



股票代號 7768



元大證券

頌勝科技材料

上市前業績發表會

Precision | Vision | Innovation

連結全球產業鏈，開創半導體材料新未來

2026.04.08 | 台北君悅酒店

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息，係本公司蒐集外部經濟發展現況並整合內部資料後所得，僅反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性，故實際營運結果、財務狀況以及業務展望可能與前瞻性資訊有所差異，其原因來自於各種公司所不能掌控的風險。
- 本公司對於前瞻性資訊不作任何聲明或保證，除非法令另有要求外，本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性資訊的義務。



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 核心優勢

03 | 市場機會

04 | 經營績效

05 | 永續發展





關於頌勝科技材料

成立時間

1986年

資本額

6億 2265萬元

主要產品

半導體研磨墊與耗材 62%

醫療與運動產品 30%

綠色環保黏著劑、PU 彈性體 8%

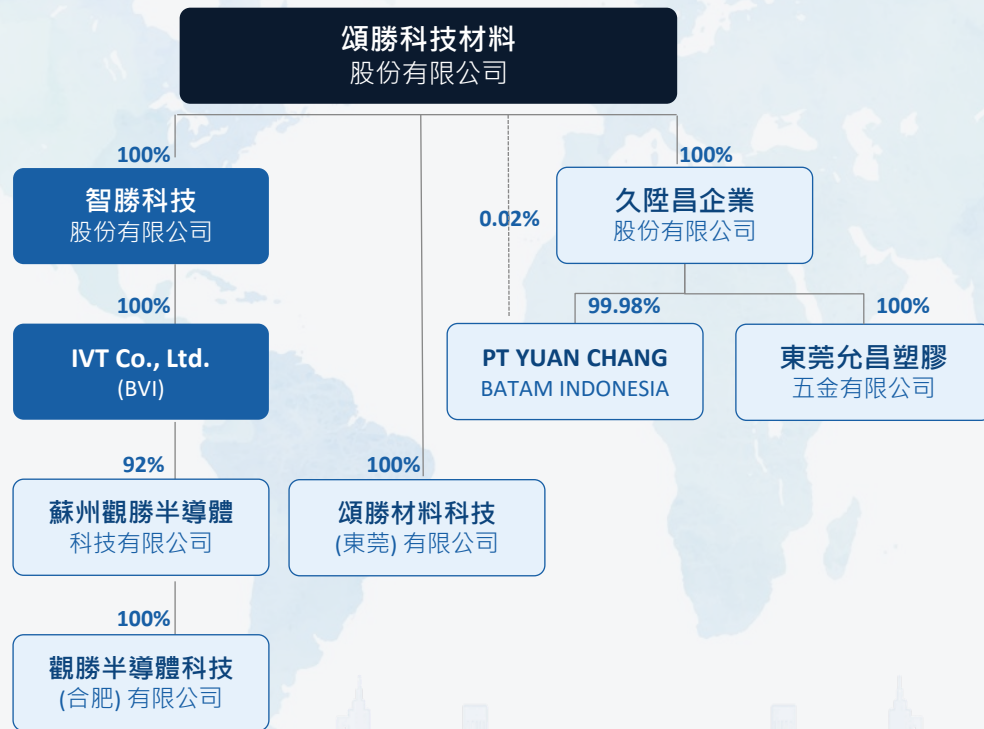
員工人數

約 801人(統計日截至2025/12)

總部

臺中市西屯區工業區14路2號

集團架構



重組過程

- **2021/06**
久陞昌收購 PT YUAN CHANG 100%
- **2022/11**
頌勝增資取得智勝及久陞昌 100%
- **2023/11**
智勝成立 BVI，收購觀勝 92%
- **2024**
成立觀勝合肥
- **2025**
成立東莞頌勝

董事會成員



董事長 朱明癸

國立聯合大學化學工程學系

頌勝科技材料(股)公司董事長

智勝科技(股)公司董事長

蘇州觀勝半導體科技有限公司董事

久陞昌企業(股)公司董事

東莞允昌塑膠五金(股)公司監事



董事長 魏隆誠

國立聯合大學化學工程學系

久陞昌企業(股)公司董事長

東莞允昌塑膠五金(股)公司董事

智勝科技(股)公司董事

觀勝半導體科技(合肥)有限公司董事

巧新科技工業(股)公司董事



董事 楊偉文

國立成功大學材料科學及工程學系 博士

智勝科技(股)公司董事/總經理

蘇州觀勝半導體科技有限公司董事/總經理

觀勝半導體科技(合肥)有限公司董事/總經理



董事 闕聖哲

美國加州州立大學製造系統工程管理研究所碩士

意德士科技(股)公司董事長兼總經理

德鑫半導體控股(股)公司董事長



獨立董事 李佳玲

中山大學管理學博士

政治大學會計系教授

國立中山大學 企業管理(學)系 博士



獨立董事 林群翔

美國南加州大學工業工程與管理碩士

台灣恩智浦半導體(股)公司董事長

美國南加州大學工業工程與管理碩士



獨立董事 方雍仁

東吳大學法律碩士

誠一國際法律事務所主持律師兼所長

東吳大學法律碩士

經營團隊



集團發展沿革與產品

化學原料產業

1986年
成立**頌勝化工**(2022年改名**頌勝科技材料**)

2022年
成立**GED傑德品牌部門**

1984年
成立**久昌化工行**

2021年
成立**綠色黏著劑部門**

2025年
成立**東莞頌勝**

1997年
成立**允昌塑膠**

健康與醫療產業

1992年
成立**久陞昌**

2012年
成立**PT YUAN CHANG**

2002年
成立**智勝科技**

2024年
成立**觀勝合肥**

2026年
觀勝合肥揭幕

2027年
中科總部啟用

半導體產業

2017年
成立**蘇州觀勝**

2025年
進駐**中部科學園區**

2026年
Soft pad產線試產



頌勝科總部



允昌塑膠(東莞)



智勝科技



PT YUAN CHANG
(印尼巴淡)



蘇州觀勝



觀勝合肥



中科總部

集團發展沿革與產品

7.74%

化學原料產業

綠色環保黏著劑

PU 彈性體



30.52%

健康與醫療產業

醫療鞋墊

運動產品



61.74%

半導體產業

晶圓研磨墊

半導體關鍵耗材



CMP PAD
研磨墊產品



SOFT PAD
拋光墊產品

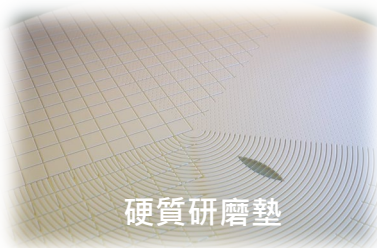


CMP
周邊耗材產品

專注半導體關鍵材料

研磨墊 Polishing Pad

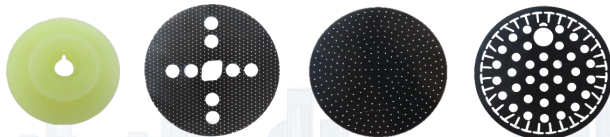
晶圓研磨墊
半導體關鍵耗材



彈性矽膠薄膜 Membrane



晶圓傳動輪/研磨頭緩衝材料 Roller / Backing Film



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 核心優勢

03 | 市場機會

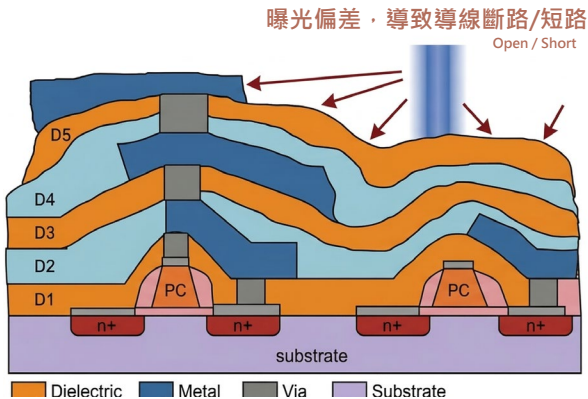
04 | 經營績效

05 | 永續發展

核心技術與競爭優勢

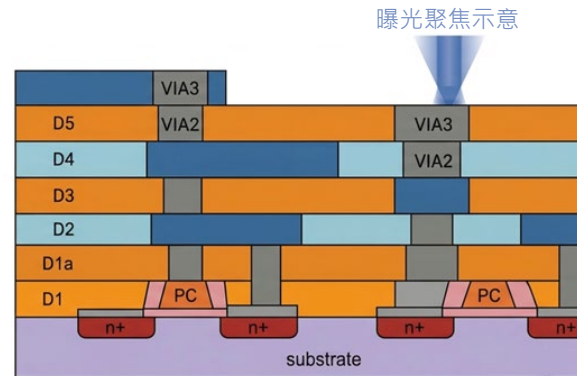
為何需要化學機械平坦化 (CMP)?

失控的形貌累積
(無使用 CMP)



資料來源：VLSI-expert.com

完美的層層堆疊
(有使用CMP)

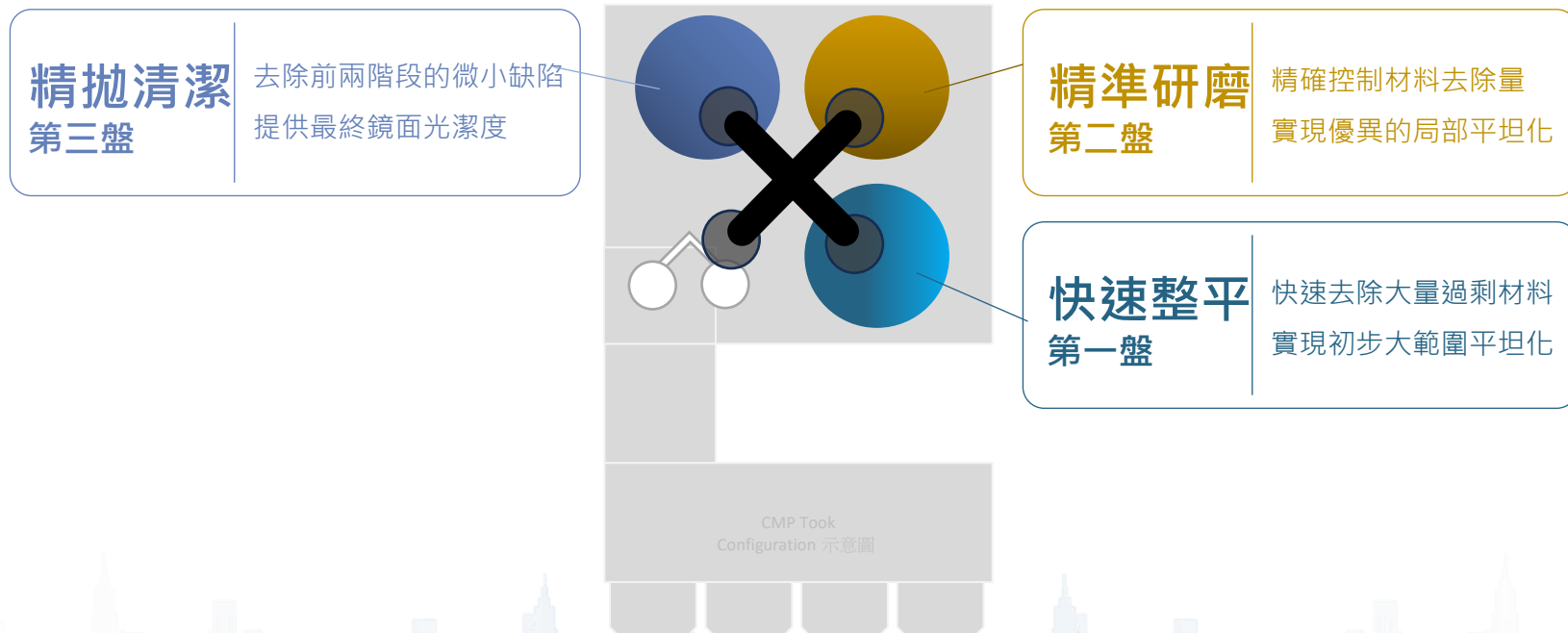


積體電路是一座微觀的互聯架構
傾斜的地基，蓋不出摩天大樓

每一層都可精準平坦化
實現高精密的電路層層堆疊

核心技術與競爭優勢

化學機械平坦化 (CMP) 的三階段解析



核心技術與競爭優勢

化學機械平坦化 (CMP) 的關鍵腳色

晶圓 前層薄膜

前層不平整輪廓
產品電路差異
各層材料差異

鑽石碟 表面修整

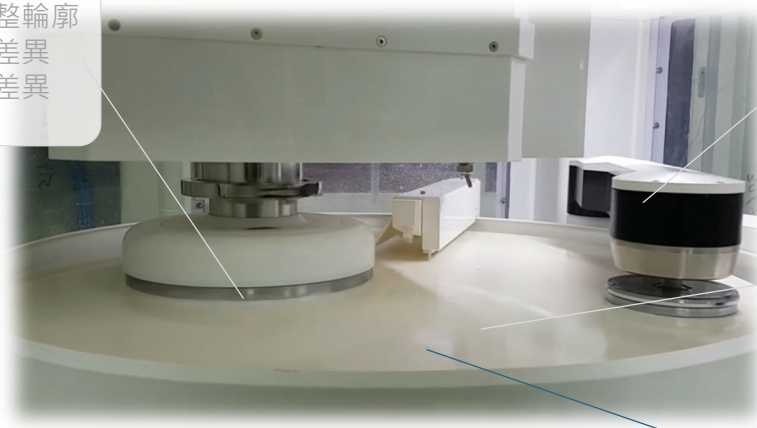
鑽石尺寸/形狀
佈鑽密度
磨耗程度

研磨液 化學作用

磨粒特性
化學添加劑
酸鹼值

研磨墊 晶圓平坦化

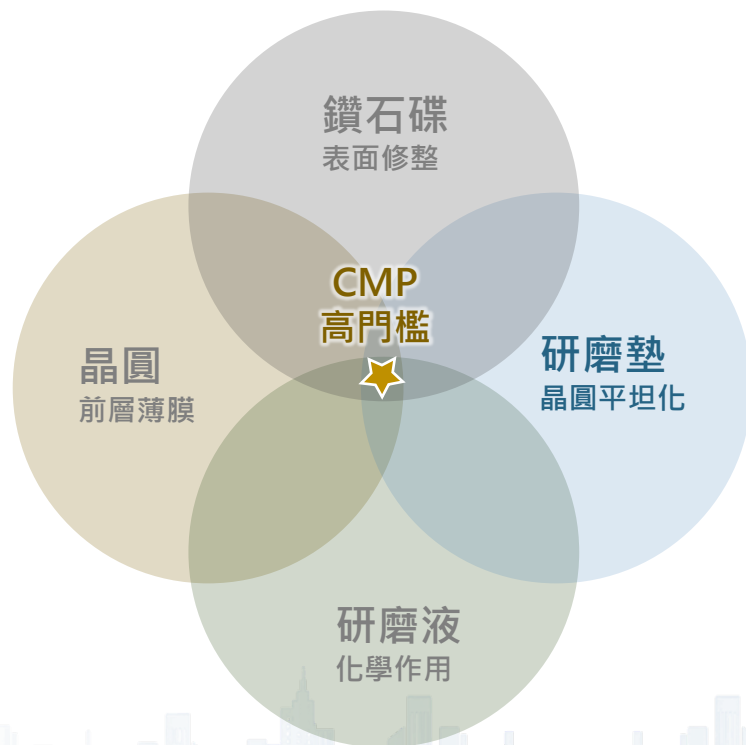
表面粗糙度
材料特性與溝槽設計
研磨墊性質



研磨墊是「直接與晶圓進行接觸」的關鍵角色

核心技術與競爭優勢

為何化學機械平坦化 (CMP) 很難有新進者？



CMP高門檻源自
「多種變因的交集成果」

核心技術與競爭優勢

為何化學機械平坦化 (CMP) 很難有新進者？



研磨墊具有三重護城河，競爭者難以複製

高度客製 | 客戶驗證

深入客戶合作調教
認證週期長且替換成本高

專利圍牆

核心技術受專利保護
競爭者難以合法複製

原料的掌控

自研且多元的配方組合

核心技術與競爭優勢

CMP為先進製造的核心賦能技術

混合鍵結(hybrid Bonding)

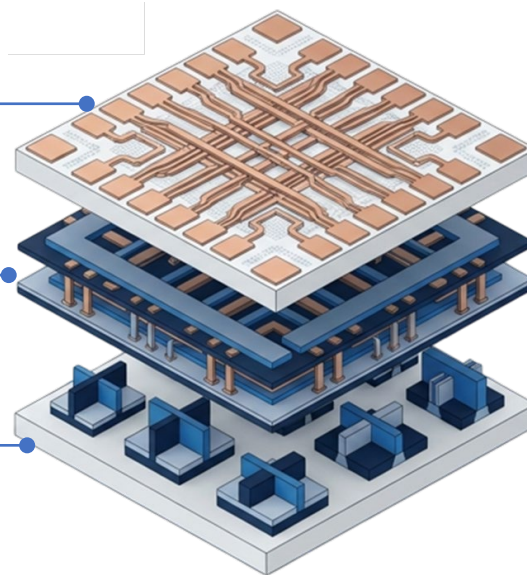
3D IC與先進封裝要求奈米級的完美鍵合介面，使CMP應用大幅增加

供電網路革命(BSPDN)

晶背供電技術的實現，完全依賴CMP作為無缺陷佈線的關鍵前置條件

先進電晶體架構

CMP的平坦化精度，直接決定先進架構(FinFET、GAAFET)的最終電性與元件性能



CMP不再是只能「被動磨平」，而是直接決定元件性能與結構可行性的關鍵技術

核心技術與競爭優勢

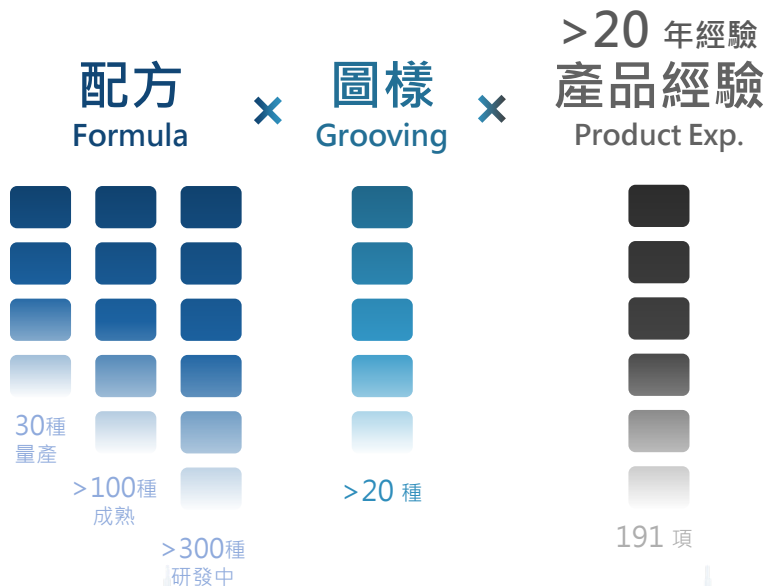
CMP已從製程配角成為決勝關鍵

	過去	現在	未來
核心功能	Supporting Process (配角)	Enabling Technology (關鍵技術)	Yield & Integration Driver (決勝製程)
技術焦點	單一層面的厚度控制 各層堆疊層間的過渡步驟	決定奈米級結構精度 新穎材料整合	先進封裝 異質整合 晶背供電 良率的最終守門員
商業價值	標準化 耗材供應	具備高度 技術壁壘與定製化需求	決定最終良率 與客戶深度合作 長期戰略綁定 具備高ASP潛力

誰能夠替客戶解決未來的問題客製化 就是最後的贏家

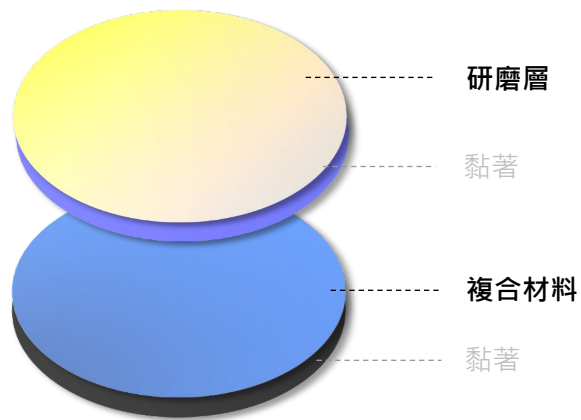
核心技術與競爭優勢

多年的經驗轉換成企業競爭優勢



核心技術與競爭優勢

獨特核心技術



01 原料設計 | 單片式無毒空氣發泡



02 溝槽設計



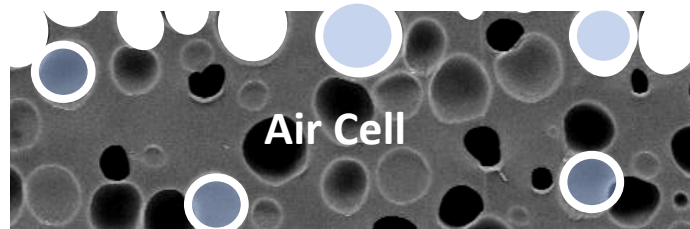
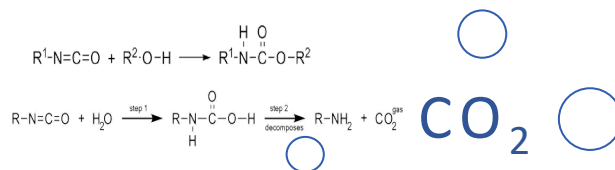
03 複合材料堆疊設計

核心技術與競爭優勢

獨特核心技術



01 原料設計 | 單片式無毒空氣發泡



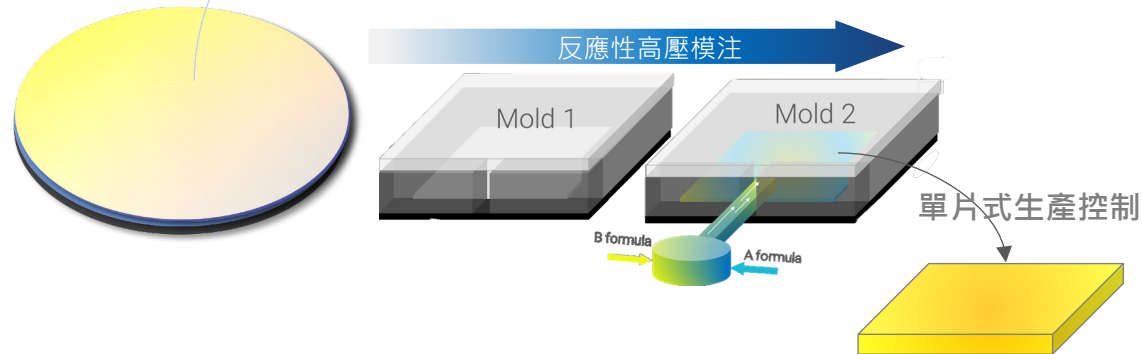
自研原料配方 | 無毒發泡 | 高品質穩定 | 孔隙可調 | 依客戶客製

核心技術與競爭優勢

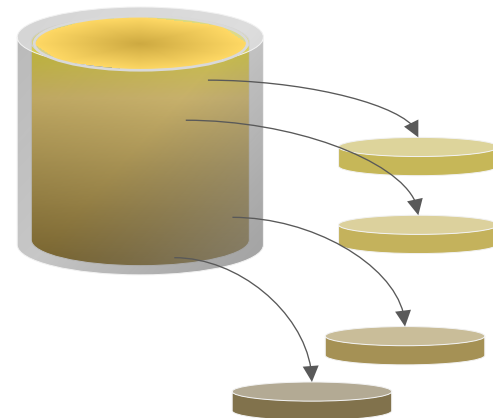
獨特核心技術



01 原料設計 | 單片式無毒空氣發泡



傳統的灌注技術 (非本公司之技術)

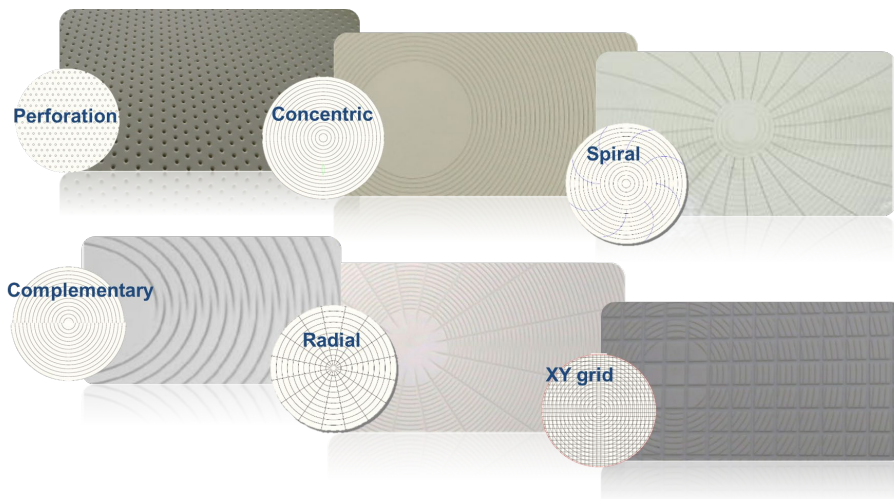
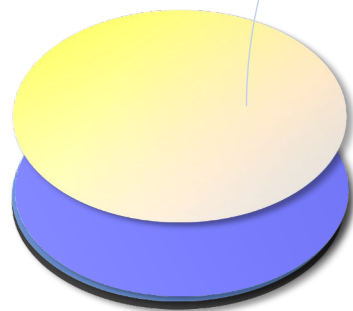


核心技術與競爭優勢

獨特核心技術



02 溝槽設計



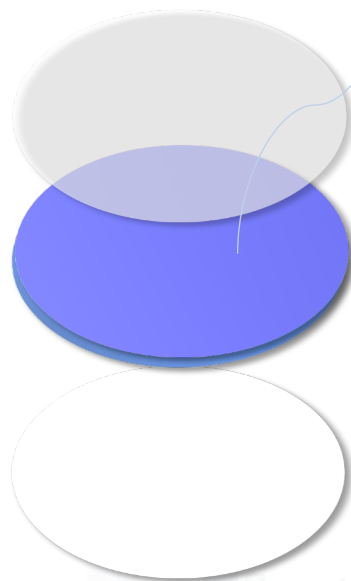
流場模擬 | 客製多元溝槽設計 | 降低客戶研磨液使用量

核心技術與競爭優勢

獨特核心技術

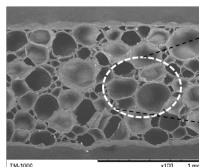


03 複合材料堆疊設計

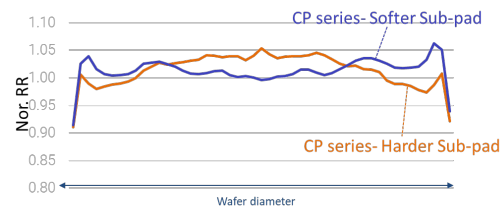
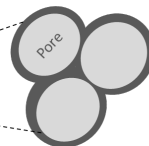


CP Sub Pad 複合層

Closed Pore

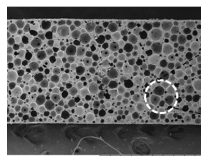


Hard rigidity due to closed pore structure

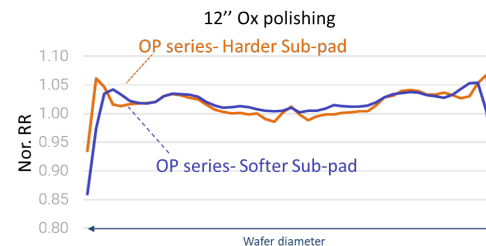
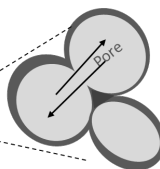


OP Sub Pad 複合層

(Opened Pore)



Softer rigidity due to opened pore structure



降低研磨應力，減少晶圓研磨缺陷 | 增進研磨均勻性 | 達成客戶多面向之要求

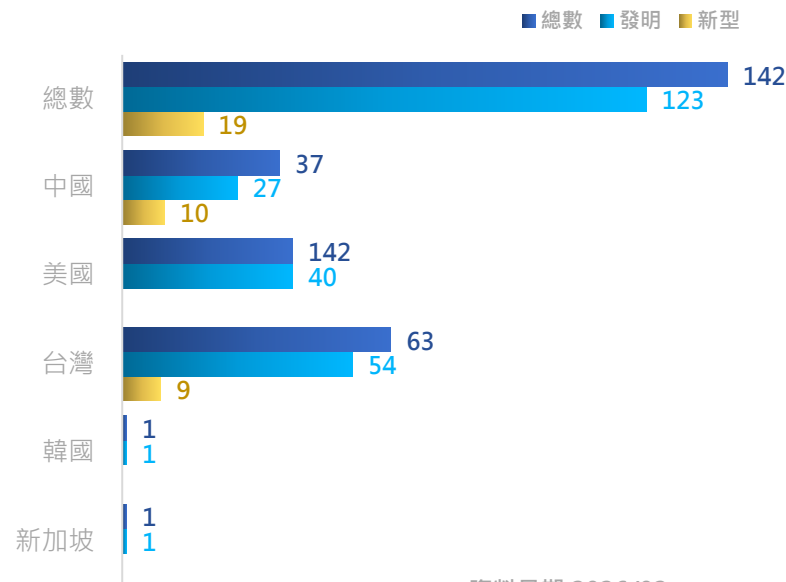
核心技術與競爭優勢

五大專利佈局堆疊形成之技術壁壘

專利類型



專利數量



資料日期 2026/02

二十年技術淬鍊，累積更多企業最關鍵的營業秘密



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 核心優勢

03 | 市場機會

04 | 經營績效

05 | 永續發展



市場機會

頌勝的切入機會

AI / HPC 帶動全球半導體市場

核心機會

強勁的AI需求帶動整體半導體市場供不應求，頌勝是唯一能切入的台灣供應商

CoWoS先進封裝研磨墊缺口

需求爆發

先進封裝產能大幅擴張，研磨墊需求缺口持續擴大，頌勝可快速響應客戶客製化需求

材料在地供應鏈趨勢

本土供應鏈

地緣政治加速材料在地化，台灣半導體客戶優先選擇本土供應商

市場機會

頌勝的切入機會

AI / HPC 帶動全球半導體市場

核心機會

強勁的AI需求帶動整體半導體市場供不應求，頌勝是唯一能切入的台灣供應商

CoWoS先進封裝研磨墊缺口

需求爆發

先進封裝產能大幅擴張，研磨墊需求缺口持續擴大，頌勝可快速響應客戶客製化需求

材料在地供應鏈趨勢

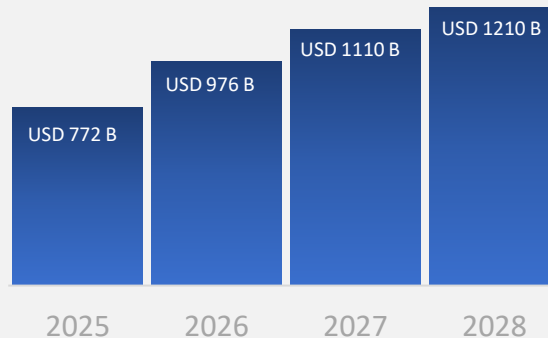
本土供應鏈

地緣政治加速材料在地化，台灣半導體客戶優先選擇本土供應商

全球半導體產業規模

1.2 兆美元
CAGR 16.1 %

2025–2028



資料來源：WSTS、MIC 資策會

市場機會

頌勝的切入機會

AI / HPC 帶動全球半導體市場

核心機會

強勁的AI需求帶動整體半導體市場供不應求，頌勝是唯一能切入的台灣供應商

CoWoS先進封裝研磨墊缺口

需求爆發

先進封裝產能大幅擴張，研磨墊需求缺口持續擴大，頌勝可快速響應客戶客製化需求

材料在地供應鏈趨勢

本土供應鏈

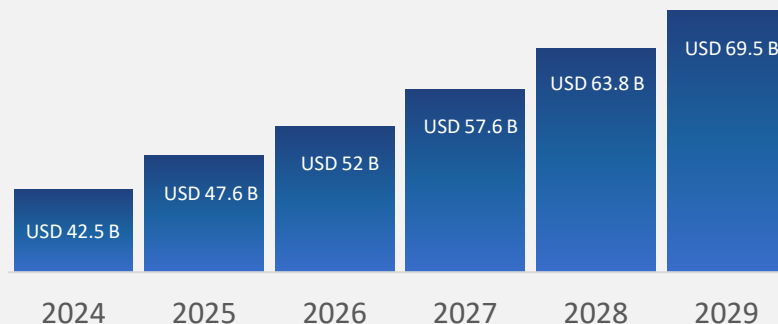
地緣政治加速材料在地化，台灣半導體客戶優先選擇本土供應商

先進封裝市場規模

695億美元

CAGR 8.9 %

2024–2029



資料來源：Yole、公司整理

市場機會

頌勝的切入機會

AI / HPC 帶動全球半導體市場

核心機會

強勁的AI需求帶動整體半導體市場供不應求，頌勝是唯一能切入的台灣供應商

CoWoS先進封裝研磨墊缺口

需求爆發

先進封裝產能大幅擴張，研磨墊需求缺口持續擴大，頌勝可快速響應客戶客製化需求

材料在地供應鏈趨勢

本土供應鏈

地緣政治加速材料在地化，台灣半導體客戶優先選擇本土供應商

研磨墊Polishing Pad市場規模

17.04億美元
CAGR 7.1 %

2023–2030

Cmp Pads Market

by Application - 300 mm Wafer, 200 mm Wafer, Others

by Type - Polymer CMP Pad, Non-woven CMP Pad, Composite CMP Pad

By Company - DuPont, Entegris, Hubei Dinglong, Fujibo, IVT Technologies, SK enpulse, KPX Chemical, TWI Incorporated, 3M, FNS TECH



M = millions and B = billions

Valuates Reports®

資料來源：Valuates Report

市場機會

頌勝的切入機會

AI / HPC 帶動全球半導體市場

核心機會

強勁的AI需求帶動整體半導體市場供不應求，頌勝是唯一能切入的台灣供應商

CoWoS先進封裝研磨墊缺口

需求爆發

先進封裝產能大幅擴張，研磨墊需求缺口持續擴大，頌勝可快速響應客戶客製化需求

材料在地供應鏈趨勢

本土供應鏈

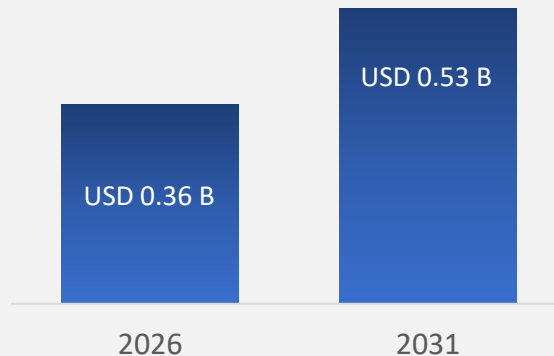
地緣政治加速材料在地化，台灣半導體客戶優先選擇本土供應商

軟質拋光墊Soft Pad市場規模

5.31億美元

CAGR 8.1 %

2026-2031



資料來源：Valuates Report

市場機會

深耕先進製程與封裝應用

	應用別	產品項目	銷售占比	代表客戶例
上游	再生晶圓 / 晶圓基板	軟質 / 硬質研磨墊 12吋 / 大尺寸	6.91%	    
中游	邏輯 / 記憶體製造	軟質 / 硬質研磨墊 8吋 / 12吋	90.20%	               
下游	先進封裝	軟質 / 硬質研磨墊 12吋	2.89%	 

市場機會與策略

多層策略堆疊



前瞻新技術

實現一開始就進入的紅利，搶佔先機

先進製程

與頂尖客戶進行深度合作開發，提升產品ASP

先進封裝

已有產品正式量產

晶背供電 | 共同封裝光學 (CPO) | TGV

既有產品- 橫向展開到新應用

將成熟產品導入全新應用領域

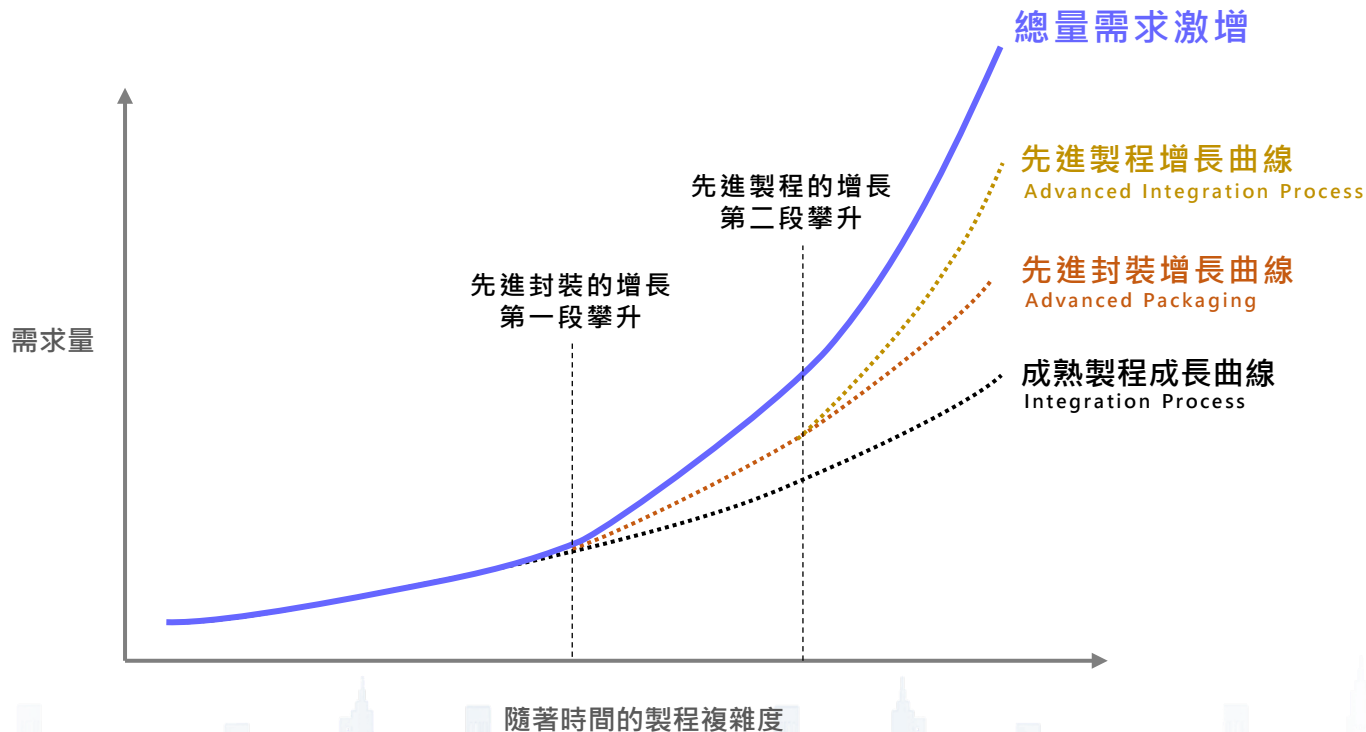
化合物半導體 | 散熱基板 | 矽光子 (SiPh)

既有產品- 受惠於地緣政治供應鏈重組

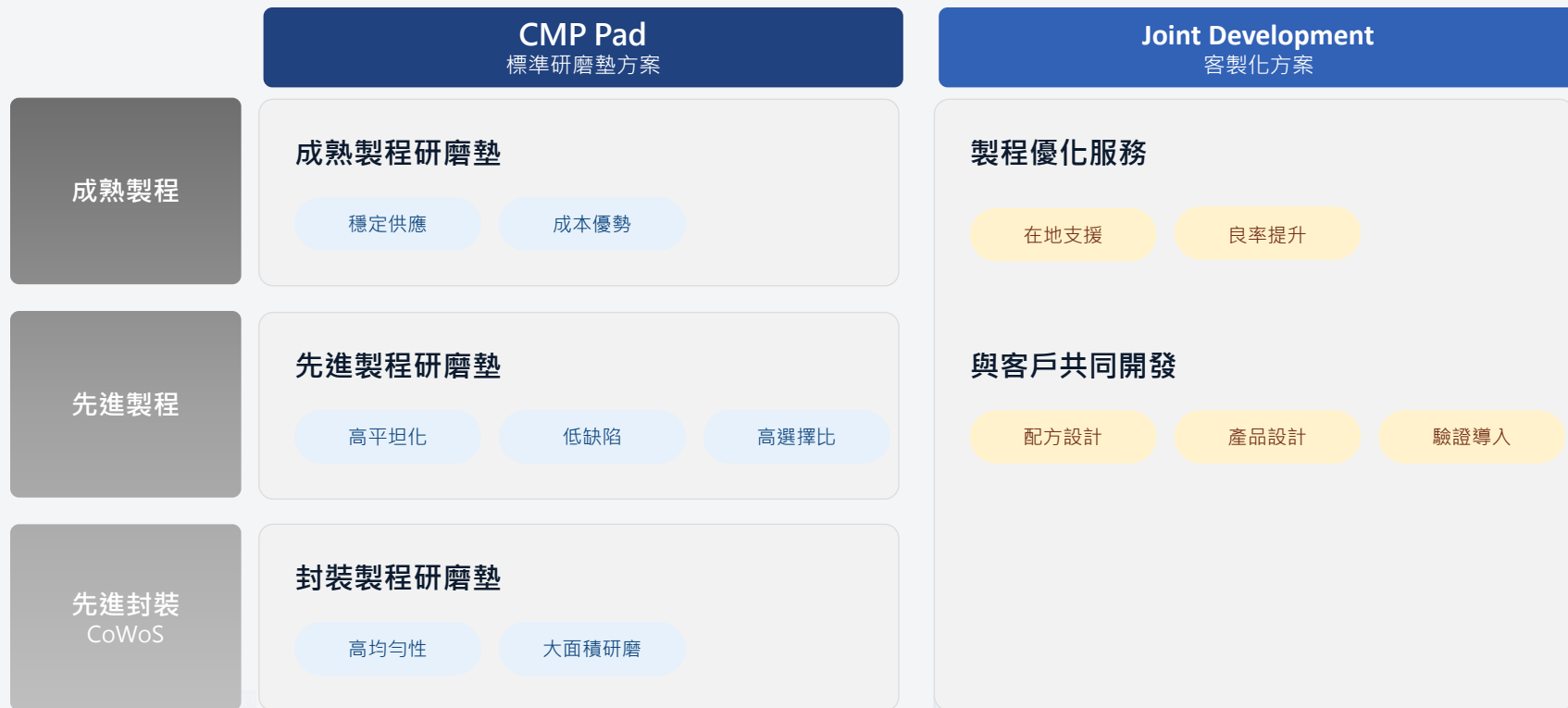
受惠於「地緣政治」帶來的供應鏈重組

市場機會與策略

成熟製程 | 先進封裝 | 先進製程 的用量攀升三曲線

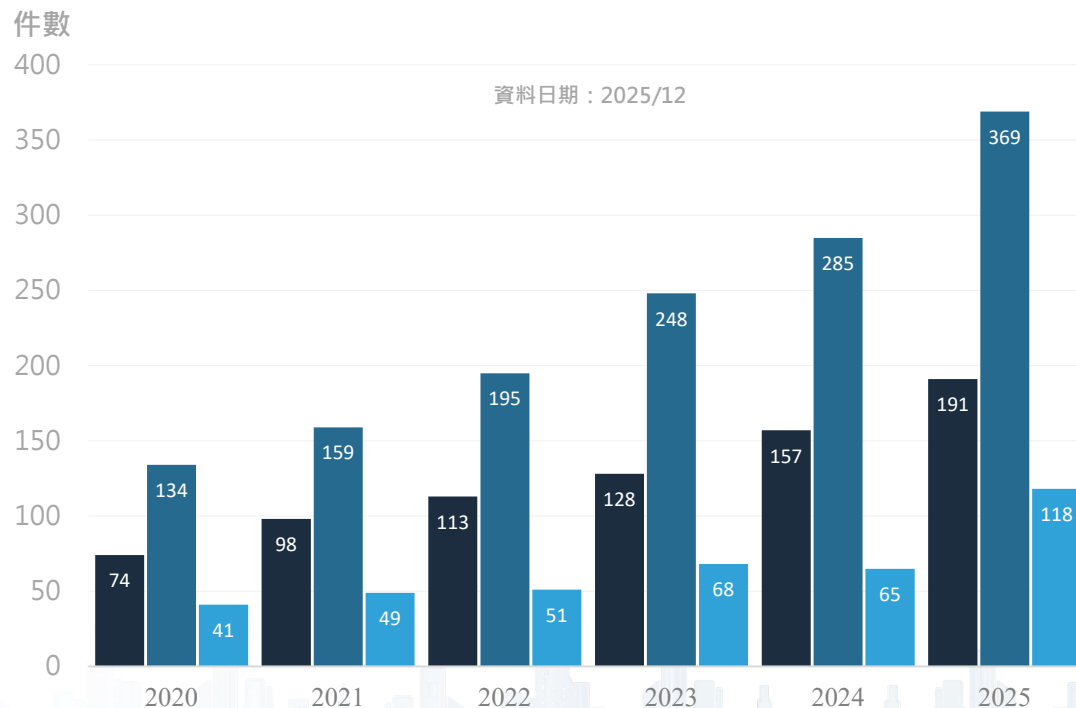


市場機會與策略



市場機會與策略

量產品穩定成長，研發數持續開案



新開專案

28%

118件

研發中專案

54%

369件

量產品

17%

191件

重點

- 量產品穩定增長
- 研發專案合作案持續轉量產
- 訂單逐步放大，推升營收

市場機會與策略

台灣與中國的雙策略引擎

China

中國觀勝合肥新廠
中國市場擴張

Taiwan

台灣中科研發中心
全球市場



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 核心優勢

03 | 市場機會

04 | 經營績效

05 | 永續發展

經營績效

營收獲利成績一覽

2025 營收

19.8

億元

2025 毛利率

50.9%

2025 營益率

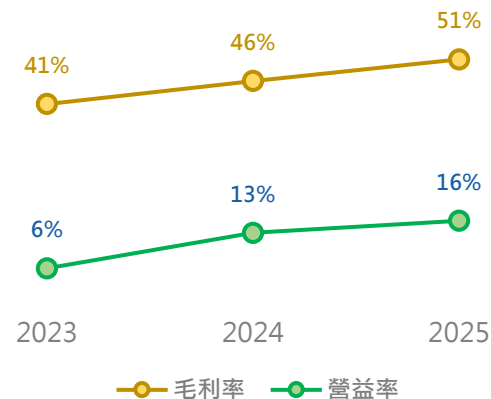
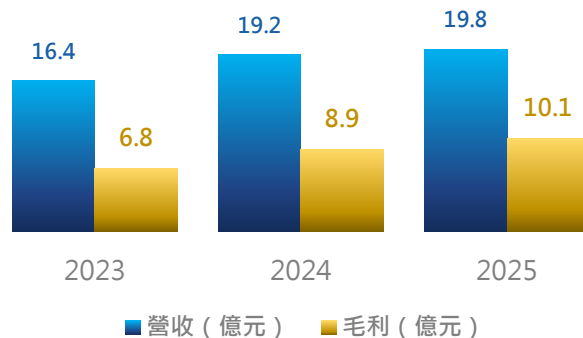
15.9%

2025 EPS

3.24

元

營收與獲利能力趨勢



經營績效

頌勝集團近三年簡明損益表

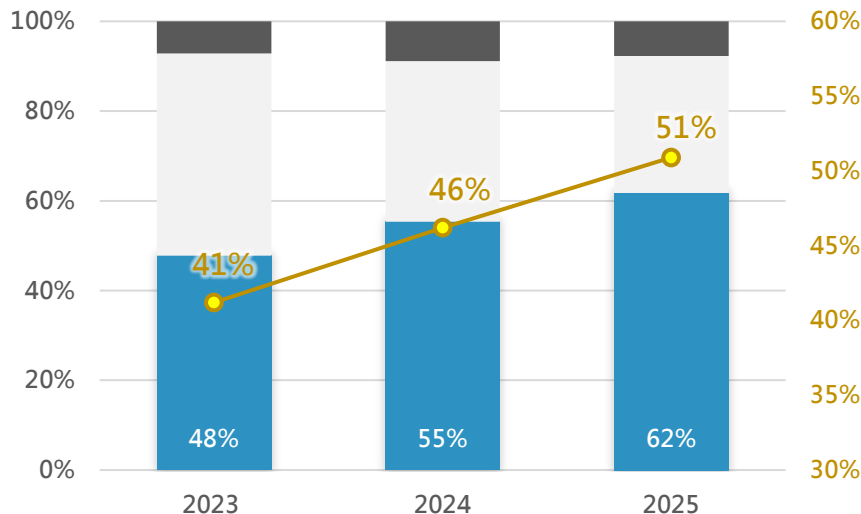
單位： 新台幣 仟元	2023	2024	2025
營業收入	1,639,092	1,921,588	1,980,776
營業毛利	675,904	888,151	1,008,573
營業損益	92,359	254,944	314,365
營業外收支	17,023	69,821	(27,535)
稅前淨利	109,382	324,765	286,830
稅後淨利歸屬於 母公司業主	47,036	229,631	191,182
前手權益	24,574	-	-
非控制權益	2,564	8,687	8,700
合計	74,174	238,318	199,882
每股盈餘	0.90	4.42	3.24
加權流通 在外股數(仟股)	51,992	51,992	59,057
期末股本	519,920	519,920	600,000

經營績效

產品結構優化驅動毛利率持續上升

■ 半導體研磨墊與耗材 ■ 醫療與運動產品 ■ 環保黏著劑等 — 總體毛利率

營收結構變化 vs 總體毛利率趨勢



半導體產品營收占比變化

48% → 55% → 62%

營業額 CAGR 25%

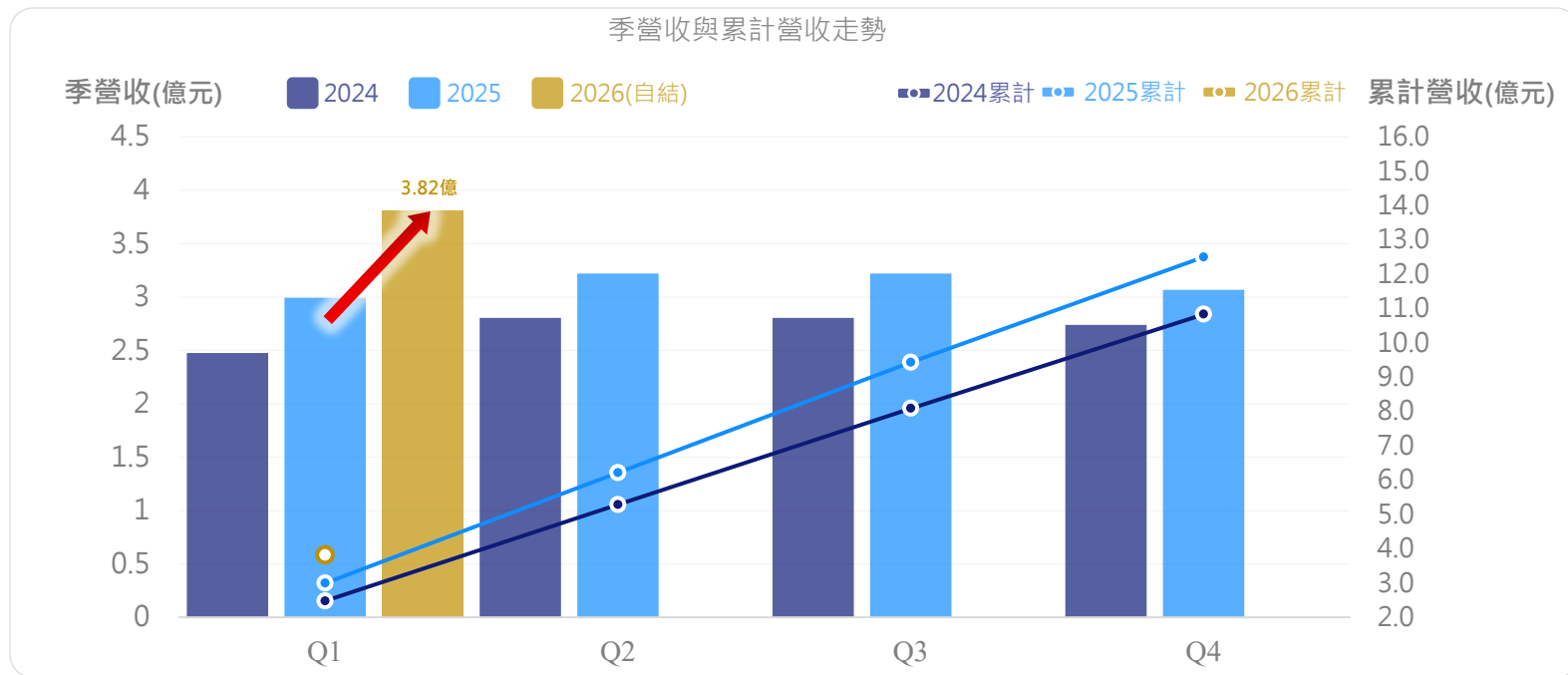
總體毛利率趨勢

41% → 46% → 51%

各產品毛利率	2023	2024	2025
半導體研磨墊與耗材	59% 7.8億	64% 10.6億	67% 12.2億
醫療與運動產品	27% 7.4億	26% 6.9億	25% 6.0億
環保黏著劑等	13% 1.2億	18% 1.7億	25% 1.5億
總體毛利率	41%	46%	51%

經營績效

半導體業務趨勢：穩基礎、降波動、強成長



2024 – 2025：營收穩定，累計營收呈現穩定趨勢

2025：季節性效應低，營收波動變小，可預測性提升

2026：成長動能明確

經營績效

半導體業務：高基期穩成長，新動能再加速

2024 平均YoY

36%

高成長

2025 平均YoY

15%

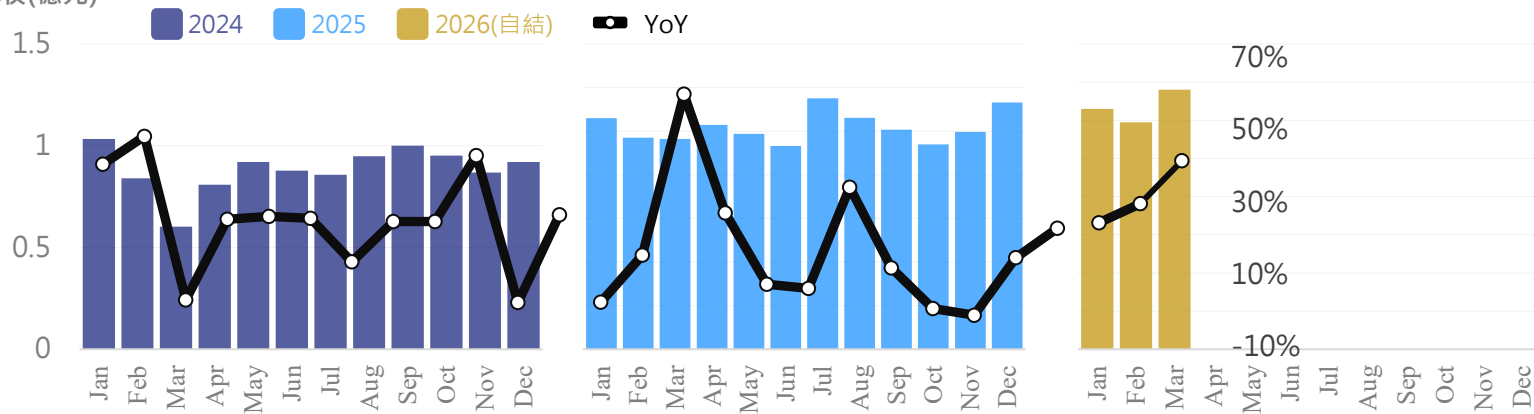
穩延續

2026 平均YoY

27%

再加速

月營收(億元)



- 連續三年平均維持雙位數成長
- 延續 2024 年 36% 的高基期，2025 年關稅變數下仍維持 15% 穩健成長
- 2026 年隨新動能發酵，成長動能再度放大至 27%



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 核心優勢

03 | 市場機會

04 | 經營績效

05 | 永續發展



永續發展

E



環境保護 綠色製程

- 製程廢棄物減量與回收再利用
- 導入節能設備降低碳排放
- 產品設計考量環境友善性

S



社會責任 深耕台灣

- 在地就業，深耕台灣人才培育
- 友善職場與人才永續
員工旅遊、免費供餐、多元訓練課程，
發行員工認股權憑證
- 產學合作深耕
台中高工、聯合大學、中興大學循環經濟學院
- 學術交流推動
成大材料論壇、學生出國競賽
- 社會關懷回饋
急難救助

G



公司治理 永續發展

- 獨立董事會席次>42%
- 設立審計委員會、薪酬委員會
- 內部稽核持續評估內控有效性
- 違反道德行為舉報系統

榮譽與肯定

國際獎項

International

2025 APEA Entrepreneur of The Year

年度最佳企業家獎



2025 APEA Corporate Excellence Award

卓越企業管理獎



2024 APEA Fast Enterprise Award

傑出企業躍進獎



2024 APEA Master Entrepreneur Award

卓越企業領袖獎



2024 鄧白氏中小企業菁英獎

第十一屆



國家 / 企業協會 / 媒體 / 客戶肯定

Government / Association / Media / Customer

2025 經濟部 潛力中堅企業獎



2025 經理人 100MVP 經理人獎

第十八屆



2025 綠色企業環保標章

2024 國家品牌玉山獎

第十八屆 最佳產品獎 先進封裝用 CMP 研磨墊



2024 金炬獎

第十八屆 年度十大企業獎、十大經理人獎



2024 創業楷模暨創業相扶獎

第四十七屆

2024 昇陽半導體 卓越技術獎

2023 SSMC Best Quality & Supplier Award

最佳品質獎、最佳供應商獎

2021 國家品牌玉山獎

傑出企業獎、傑出企業領導人首獎



2013-23 SSMC Best Quality & Supplier Award

最佳品質獎、最佳供應商獎

2023 銅塔獎

財團法人中衛發展中心台灣持續改善競賽



2023 金峰獎

第二十二屆 傑出企業獎、傑出領導人獎



站在半導體浪潮上 打造材料新格局

Create Many Possibilities